


2026年6月24日

世界初となる宇宙空間での半導体材料量産製造を目指す 「株式会社 BEAM Technologies」 への出資について

ごうぎんキャピタル株式会社が運営する「ごうぎんご縁結び1号ファンド(以下、当ファンド)」は、地上では製造困難な超高品質・高性能な半導体材料の製造を目指す株式会社 BEAM Technologies (以下、当社) に出資いたしましたので、お知らせします。

記

1. 出資先概要

出資先	株式会社 BEAM Technologies 代表取締役 飯村 一樹	
所在地	東京都千代田区二番町9番地3	
出資形態	株式(第三者割当増資)の引き受け	
事業内容	宇宙の無重力環境を活用した高性能な半導体材料の製造	
設立	2022年3月31日	
ホームページ	https://beam-tec.co.jp/	

2. 当社事業の特徴と出資背景

当社は、理化学研究所で培われた世界トップレベルの化合物半導体材料の開発技術を基盤に、宇宙空間の無重力に近い環境を活用して、地上環境では製造が難しい高性能な半導体を生み出す革新的な研究を進めるスタートアップです。

半導体は大きく、シリコン半導体と化合物半導体の2種類に分けられます。現在の市場ではシリコン半導体が大半を占めていますが、今後は生成 AI 向けデータセンターや次世代通信、電動化の進展などを背景に、より高性能・高効率な化合物半導体の重要性が一層高まることを見込まれています。

一方で、地上での製造では重力などの影響により材料の偏りやゆがみ、不純物の混入が生じやすく、品質の均一化や生産性の確保が大きな課題となっています。

当社は、理化学研究所で培った世界トップレベルの化合物半導体材料の開発技術と、それに裏付けされた高度なシミュレーション技術を有しており、これらを強みに、実現すれば世界初となる宇宙空間での化合物半導体材料の量産製造に向けて驚異的なスピードで研究開発を進めています。宇宙の無重力に近い環境を活用することで地上では難しかった品質のばらつきを抑え、より均一で高品質な化合物半導体材料の製造を可能にできると考えています。

この技術によって、次世代の半導体製造における大きな課題を解決し、当社が世界の情報通信・産業インフラの進化を支える存在となることを期待しています。

今回の出資を通じて、山陰合同銀行グループの広域ネットワークを活用した連携先の紹介や顧客開拓支援を行い、同社技術のさらなる発展と事業成長を後押ししてまいります。

以上